

第56回エンジニアリングセラミックスセミナー

「機械学習・深層学習を利用した材料研究・開発の最前線」

近年、情報科学を積極的に取り入れた材料の研究開発が行われています。エンジニアリングセラミックスの分野においても、これまでに知られていないさまざまな知見が得られています。本セミナーでは、機械学習をエンジニアリングセラミックス及び周辺技術に取り入れた研究開発に取り組んでいらっしゃる気鋭の先生方をお招きし、当該分野の最新動向、また今後の展望についてご講演いただきます。

主催：日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会
協賛：日本化学会、日本金属学会、耐火物技術協会、粉体粉末冶金協会、粉体工学会、日本ファインセラミックス協会（予定）

開催日時：2025年12月5日（金）13:30～

場所：東京大学（本郷キャンパス）山上会館 大会議室

URL：https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/society/facilities/b07_11.html

定員：100名

参加費：会員 13,000円（協賛学協会含む）、学生会員 6,000円、非会員 15,000円
（申込時入会は会員扱）（消費税・テキスト代込）

申込方法：HP（http://www.ceramic.or.jp/bkouon/index_j.html）の申込フォームよりお申し込みください。参加費はセミナー前日までに銀行振込にてご送金ください。お申込後の取り消しによる返金はいたしません。

問合せ先：〒169-0073 東京都新宿区百人町2-22-17

公益社団法人日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会

Email：encera[at]cersj.org（[at]部分を@に変えて下さい。）

振込先：三菱UFJ銀行千里中央支店（普）0073211

（公社）日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会 名義
銀行振込の振込受領書を領収書にかえさせていただきます

【プログラム】

13:30-13:35 開会挨拶

部会長 京セラ(株) 織田武廣

13:35-14:15 「所望の物性と最適プロセスを予測する AI 技術の開発」

産業技術総合研究所 福島 学

14:15-14:55 「多面体に基づくイオン伝導体の設計」

パナソニック ホールディングス株式会社 横山 智康

休憩

15:20-16:00 「遮熱性と光学特性に優れるハイエントロピー酸化物の組成設計」

一般財団法人ファインセラミックスセンター 小川 貴史

16:00-16:40 「極限環境利用でのセラミックス基複合材料の応答予測

—サロゲートモデル構築とパラメータ推定に向けて」

東北大学 菊川豪太

16:40-17:20 「4D 画像によるセラミックス基複合材料のひずみ計測と AI を活用した画像解析」

Thermo Fisher Scientific 伊藤 栄祐

17:20 閉会挨拶

副部会長 横浜国立大学 多々見 純一